

# 半导体产业新闻半月刊（精华版）

2019/0311-2019/0324



# 专题分类



## 并购投资

- 点评：
- ①英伟达69亿美元收购Mellanox，扩展数据及AI业务。
  - ②晶方科技收购Anteryon，补齐3D Sensing光学能力短板。
  - ③云从科技完成C轮融资。
  - ④智路与AMS共建合资企业，推出环境传感器解决方案。



领域	时间	事件	原因/内容	资金(美元)
服务器芯片	2019/03/11	英伟达收购Mellanox	<b>业务增强</b> 。这将是英伟达公司历史上规模最大的一笔收购交易，将提振英伟达的服务器芯片制造业务，从而减少对视频游戏行业的依赖。	70亿
光电	2019/03/08	晶方科技收购Anteryon	<b>优势互补</b> 。有利于晶方科技的产业链延伸与布局，并通过获得传感器发展所需的核心技术与制造能力，快速有效进入智慧物联网、自动驾驶、虚拟及增强现实、医疗和智能制造相关的新兴应用领域。	0.36亿
AI	2019/03/14	云从科技完成C轮融资	<b>战略融资</b> 。投资方为盛世景、新企投资、张江浩成、金泉投资、新余卓安投资管理中心（有限合伙）、旺泰恒辉投资基金、粤科鑫泰股权投资基金。	
大硅片	2019/03/19	上海新阳：拟将所持上海新昇26.06%股权转让给上海硅产业集团	<b>股权交易</b> 。交易完成后，上海新阳将获得上海硅产业集团1.47亿股份，仍持有上海新昇1.5%的股权，上海硅产业集团持有上海新昇股权增加为98.5%	0.7亿
传感器	2019/03/20	智路与AMS签约成立环境传感器合资公司	<b>强强联手</b> 。为全球市场推进环境、流量和压力传感器解决方案的开发和销售，3月18日，智路与AMS奥地利半导体签约，共同创建一个合资企业。	



## 本土产业

- 点评：
- ①浙江10家企业宣布出资设立集成电路产业投资公司。
  - ②中电科拟募资超6亿投建8英寸特色中试工艺平台。
  - ③富士康与珠海市政府签署合作协议，将对珠海IC晶圆厂进行支援与推展。
  - ④总投资80亿，山东开工重大半导体硅片材料项目。



## 【浙江成立集成电路投资公司】

- ① 近日，浙江宣布成立集成dialup投资公司浙江富浙集成电路产业发展有限公司，该公司注册资本为150亿元，经营范围为股权投资、实业投资、投资咨询等，投资方向为集成电路产业及相关领域。
- ② 参与设立浙江富浙集成电路产业发展有限公司的企业包括：巨化股份、浙江省国资公司、浙江省金控、浙江烟草公司、杭钢集团、嘉兴市嘉实金控、绍兴市国资公司、衢州市金控集团、杭州市国资公司、宁波工业投资集团、巨化集团等。

## 【中电科拟募资超6亿投建8英寸特色中试工艺平】

近日，中国电子科技集团旗下全资子公司中电科投资控股有限公司在北京产权交易所发布“重庆中科渝芯电子有限公司增资项目”，拟通过引入投资方、募资不低于6亿元用于投建8英寸特色中试工艺平台。

## 【住友电工新能源汽车机电线项目落户常州】

3月7日，总投资1.8亿美元的日本住友电气工业株式会社常州新能源汽车机电线项目签约落户常州高新区。



## 【厦门首家半导体设备生产企业投产】

近日，厦门市首家半导体设备生产企业—厦门鑫天虹公司在火炬高新区正式投产。鑫天虹的投产，弥补了火炬高新区集成电路产业链在制造设备环节上的缺失，使厦门市集成电路产业的竞争力进一步增强。

## 【国微集团与西安电子科技大学联合成立EDA研究院】

3月16日，国微集团与西安电子科技大学联合举办西电国微EDA研究院揭牌仪式暨专家报告会。研究院是依托西电的优势学科，面向国家战略需求及世界科技前沿的重要战略合作。希望研究院能够最大限度地汇聚和发挥高校与企业的优势和特长，立足打造国际一流的微电子核心技术研发平台和高层次人才培养基地。

## 【富士康晶圆厂落户珠海】

3月18日，富士康在深圳召开发布会，宣布富士康及其珠海项目团队与珠海市政府签署了战略合作协议，将在珠海对系统IC晶圆厂的建设与设备采购等各种晶圆厂的运营事项进行支持。

## 【苹果中国第二个数据中心在内蒙古开工】

3月15日，苹果（乌兰察布）数据中心项目举行了开工仪式，该项目位于内蒙古乌兰察布市，是苹果在中国建立的第二个数据中心。



## 【山东开工大硅片项目】

- ① 3月19日，德州经济技术开发区举行山东有研集成电路用大尺寸硅材料规模化生产项目开工仪式。
- ② 项目总投资约80亿元，分两期建设，一期新建年产180万片8英寸硅片生产线，预计今年5月中旬启动主体建设，达产后年可实现年销售收入10亿元、利税2亿元。项目二期规划年产360万片12英寸硅片，可实现年销售收入25亿元、利税6亿元。

## 【LGD广州8.5代OLED产线即将投产】

近日，LGD TV全球事业部长吴彰浩对媒体表示，LGD在广州投资的8.5代OLED面板生产线将于今年第三季正式投产，这将在一定程度上解决大尺寸OLED面板市场产能不足的问题。



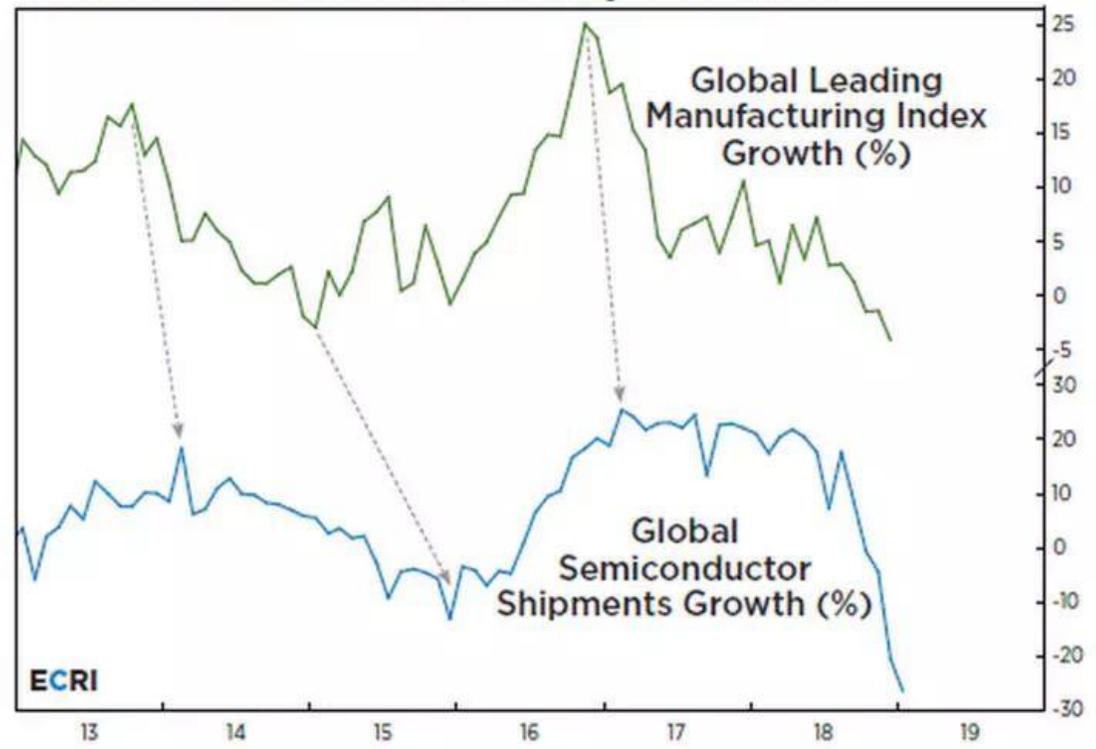
## 市场数据

- 点评：
- ①全球市场半年跌幅20%，ECRI预测半导体崩盘。
  - ②第一季全球前十大晶圆代工营收排名出炉，台积电市占率达48.1%。
  - ③2018 TOP15半导体设备厂商排名出炉，日本企业占了半壁江山。
  - ④全球晶圆厂2019年设备支出将下滑，但2020年会再创新高。



### 【ECRI：全球半导体市场半年跌幅20%】

A Leading Index of Semiconductor Shipments 数据来自：ECRI

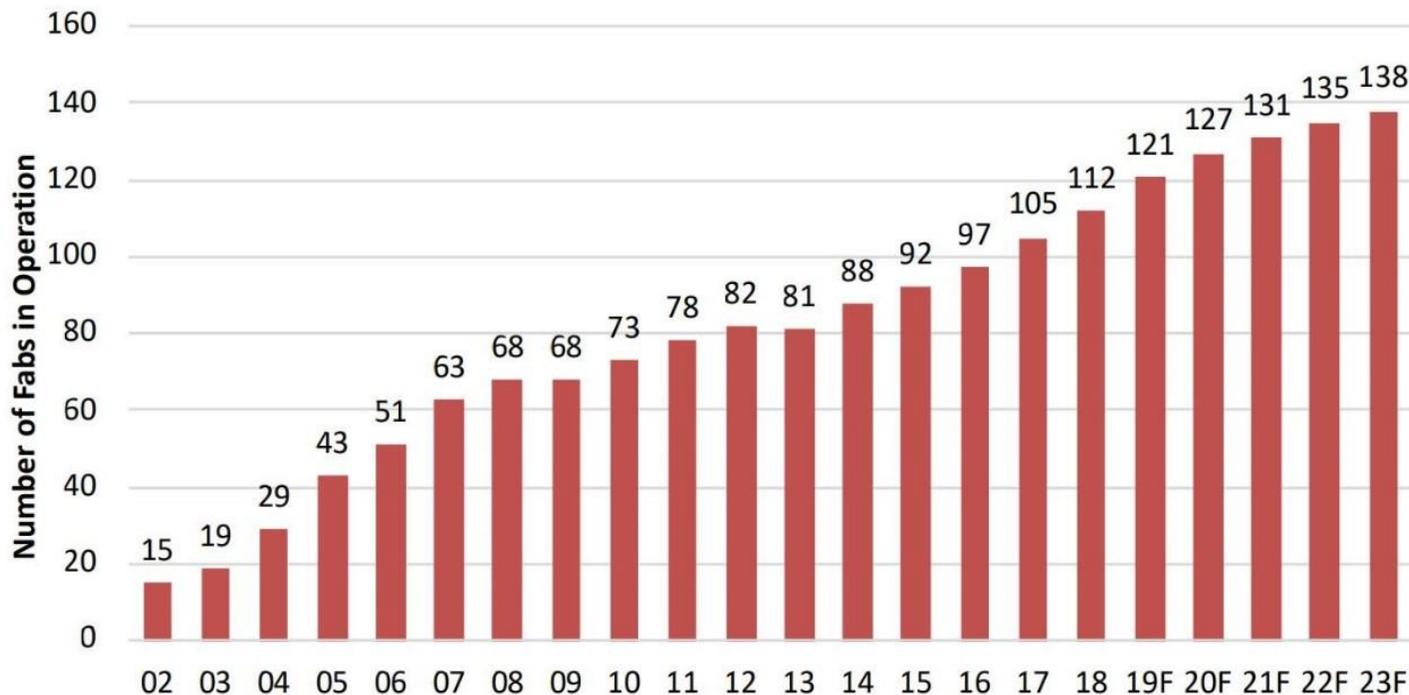


美国ECRI报道，全球半导体市场从去年8月至今下滑了20%，半导体的需求增速已经达到了十年来的最低水平。



# 【预计到2019年300毫米IC晶圆厂的数量将达到121个】

### Number of IC Fabs Processing 300mm Wafers



Includes pilot- and volume-production-class, but not R&D, fab facilities (IC fabs only). Significantly sized phases are counted as separate fabs (e.g., TSMC's Fab 14 has seven phases for a total of 370K wafers).

Source: IC Insights

随着九个新的300毫米晶圆厂计划于2019年开业，Icinsight预计今年全球运营的300毫米晶圆厂数量将攀升至121个。



## 【第一季度晶圆代工厂营收排名出炉】

Figure: Top Ten Foundries in 1Q19, Ranked (Unit: Million USD)

Rank	Company Name	1Q18 Revenue	1Q19 Revenue (E)	1Q19 Market Share (E)	1Q19 Revenue Growth YoY (E)
1	TSMC	8,547	7,028	48.1%	-17.8%
2	Samsung	3,253	2,785	19.1%	-14.4%
3	GlobalFoundries	1,513	1,234	8.4%	-18.4%
4	UMC	1,292	1,058	7.2%	-18.1%
5	SMIC	891	654	4.5%	-21.3%
6	Tower Semiconductor	313	310	2.1%	-0.9%
7	Powerchip Semiconductor	341	251	1.7%	-26.4%
8	VIS	221	225	1.5%	1.6%
9	Hua Hong Semiconductor	210	220	1.5%	4.7%
10	Dongbu HiTek	131	132	0.9%	1.1%

Note:  
 1. Samsung's revenue include those from its System LSI and Foundry Business  
 2. GlobalFoundries' revenue include that of its IBM Business  
 3. Only foundry revenue was included for Powerchip Semiconductor  
 Source: TrendForce, Mar. 2019

- ① TrendForce发布的最新研究报告指出，由于大多数终端市场（包括智能手机）的需求减弱，先进制程的发展趋势放缓。晶圆代工厂在今年第一季度面临严峻挑战，预计第一季度全球晶圆代工生产收入仅有146亿美元，同比下降约16%。
- ② 报告显示，台积电、三星和格芯分列市场份额的前三甲，虽然台积电的市场份额高达48.1%，但同比增长却下降近18%。



## 【芯思想推出中国首个大陆晶圆厂排名】

中国大陆本土晶圆代工营收排名榜

排名	公司	2017年	2018年	年增长率
1	中芯国际	20840.00	22580.00	8.35%
2	华虹集团*	9500.00	10700.00	12.63%
3	华润微电子	3190.00	3470.00	8.78%
4	武汉新芯	2200.00	2700.00	22.73%
5	上海积塔	1010.00	1050.00	3.96%
6	方正微电子	330.00	336.00	1.82%
7	晶合集成	100.00	300.00	200.00%
	合计	37170.00	41136.00	10.67%

\*华虹集团营收包括华虹宏力和华力微的营收

来源：各公司，芯思想研究院ChipInsights 2019.03

单位：百万元人民币

2018年中国大陆本土晶圆代工营收前七大合计营收为411亿元人民币，较2017年372亿元人民币增长10.7%。中芯国际以226亿元人民币排名第一，华虹集团以108亿元人民币排名第二。



# 【TOP15半导体设备厂商排名出炉，日本企业占了半壁江山】

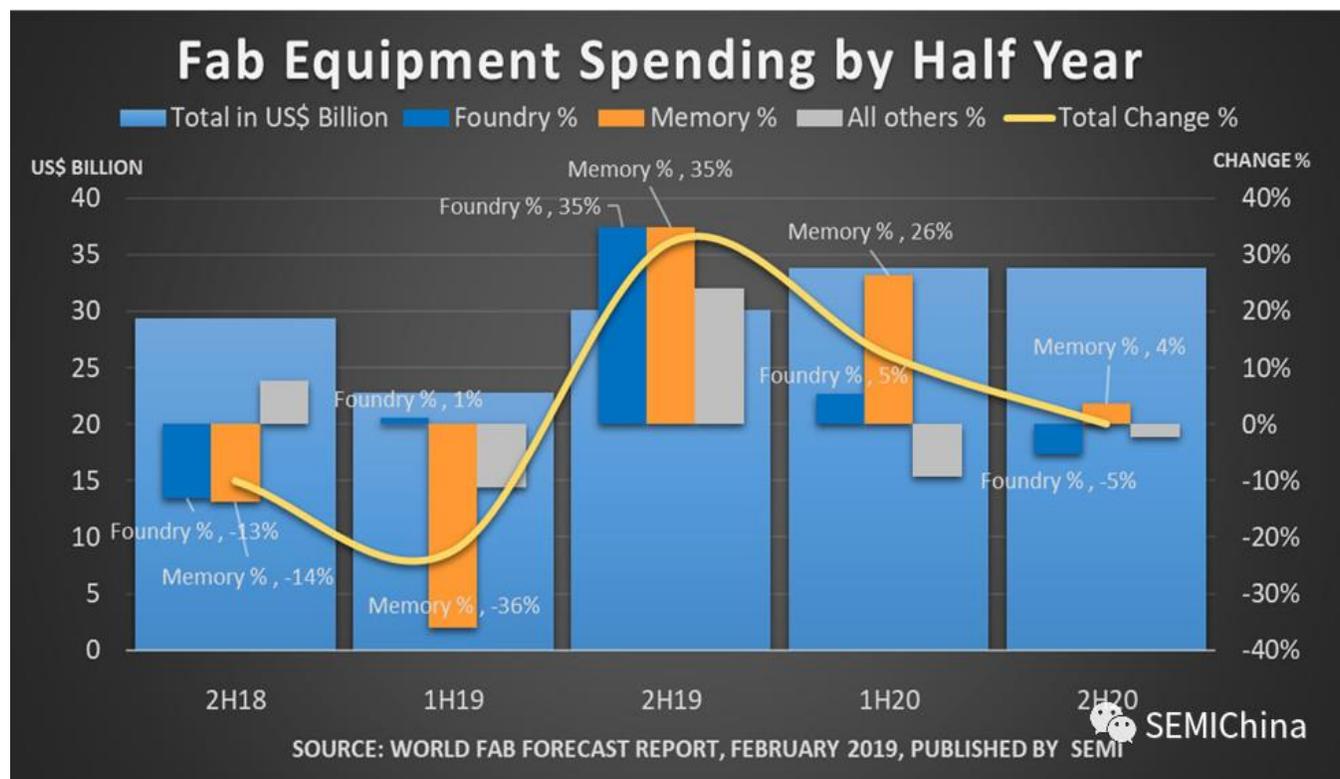
2018 Ranking	AOW	COMPANY	2017	2018	Y-o-Y Growth
1	NA	Applied Materials	13154.6	14016.1	6.5%
2	EU	ASML	9758.3	12771.6	30.9%
3	JA	Tokyo Electron	8675.1	10914.8	25.8%
4	NA	Lam Research	9558.0	10871.4	13.7%
5	NA	KLA	3689.0	4209.8	14.1%
6	JA	Advantest	1673.8	2593.3	54.9%
7	JA	SCREEN	1863.5	2226.0	19.5%
8	NA	Teradyne	1663.0	1492.0	-10.3%
9	JA	Kokusai Electric	1181.6	1486.0	25.8%
10	JA	Hitachi High-Technologies	1200.3	1402.7	16.9%
11	CH	ASM Pacific Technology	1107.3	1181.2	6.7%
12	KS	SEMES	1353.0	1173.9	-13.2%
13	EU	ASM International	836.0	991.2	18.6%
14	JA	Daifuku	724.6	971.5	34.1%
15	JA	Canon	499.4	765.4	53.3%
<b>Total Top OEMs</b>			<b>56937.5</b>	<b>67066.9</b>	<b>17.8%</b>
Total IC Mfg Equipment (Preliminary)			<b>70280.6</b>	<b>81140.3</b>	<b>15.5%</b>

单位:百万美金。

据美国VLSI Research发布的2018年全球半导体生产设备厂商的排名结果来看，日本厂商占据7家，美国厂商有4家、欧洲厂商有3家，中国和韩国各有1家，可以说日本企业在半导体生产设备业界的奋斗着实引人注目。



# 【全球晶圆厂2019年设备支出将下滑，但2020年会再创新高】

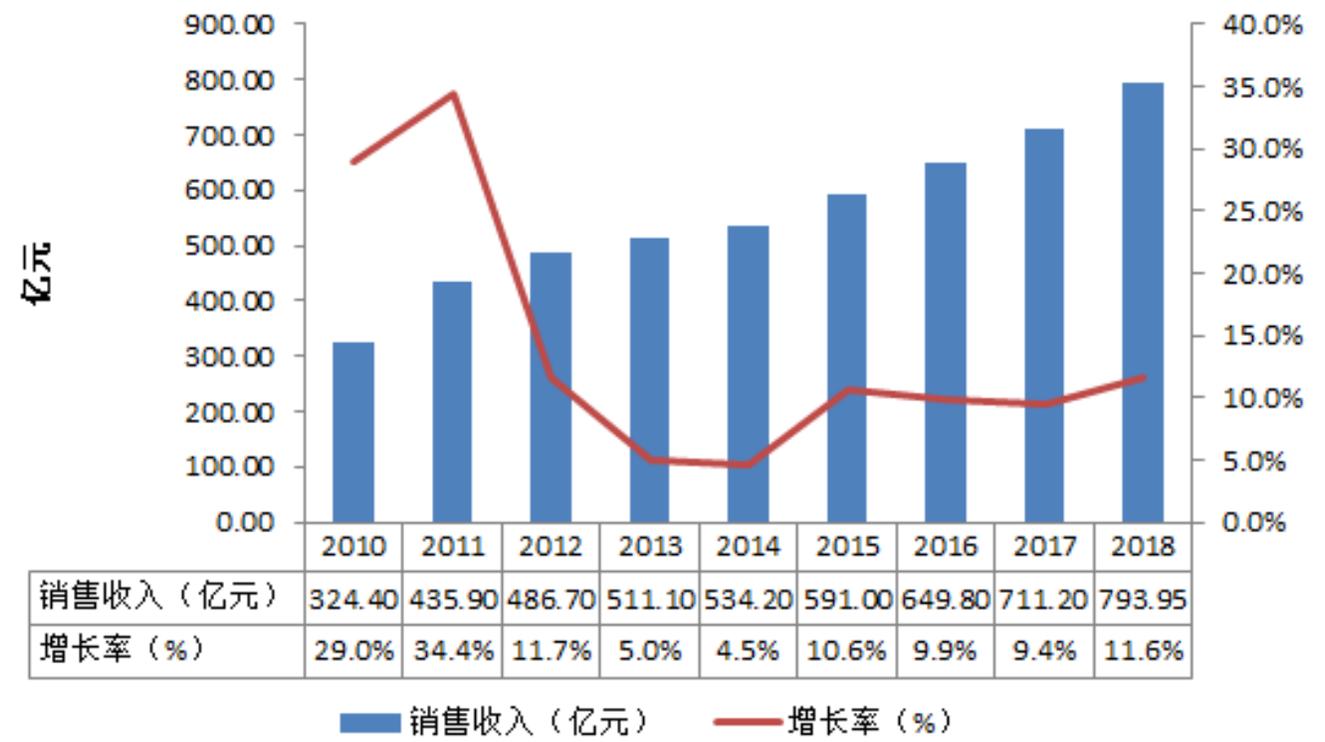


根据SEMI行业研究与统计团队发布的2019年第一季度世界晶圆厂预测报告，2019年全球晶圆厂设备支出预计将下降14%（530亿美元），但2020年将强劲复苏27%（670亿美元），创下新纪录。受memory行业放缓的刺激，2019年的低迷标志着晶圆厂设备支出三年持续增长告一段落。



## 【2018年中国集成电路材料制造业发展情况】

2010-2018 年中国集成电路材料市场规模



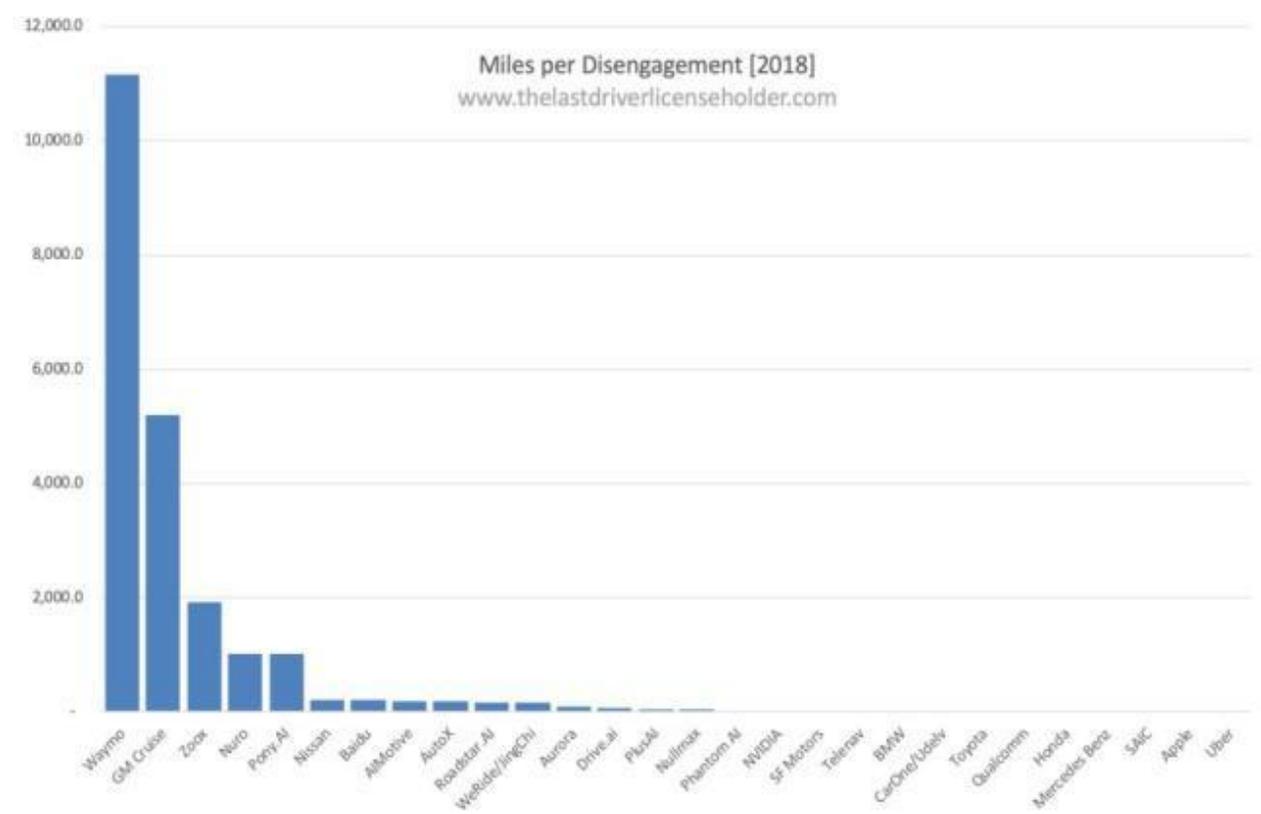
CAGR=11.84%(2010-2018年)

资料来源: JSSIA 整理

据jssia调研整理: 2018年中国集成电路材料市场销售收入为793.95亿元, 同比增长11.6%, 其中集成电路晶圆制造业材料市场规模为407.8亿元, 同比增长11.8%, 封装材料市场规模为386.15亿元, 同比增长11.47%。



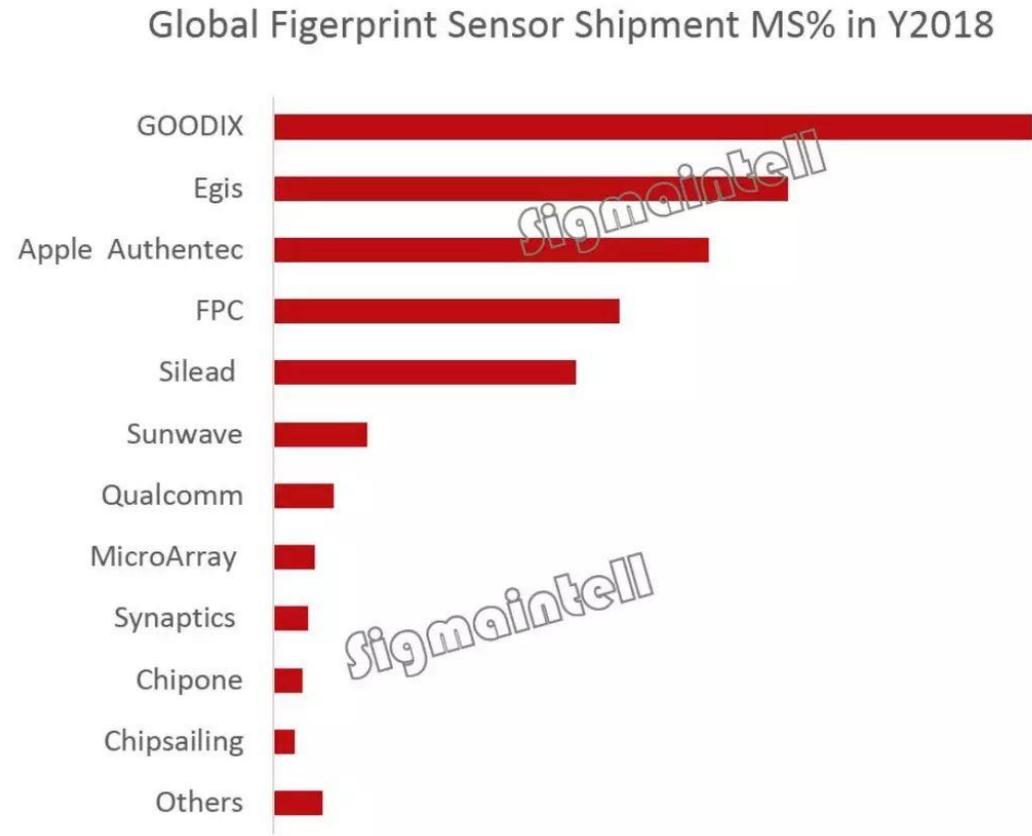
【目前有48家企业正在美国测试自动驾驶汽车】



加州车辆管理局（DMV）发布了2017年12月-2018年11月无人驾驶汽车测试牌照方面的数据。目前有48家企业正在测试自动驾驶汽车，28家企业在加州公共道路上公开测试467量自动驾驶汽车。



【2018年全球指纹识别芯片出货量同比降18.8%】



根据群智咨询《全球指纹识别芯片市场跟踪与预测报告》显示，由于终端整体需求下降和3D面部识别的竞争，2018年指纹传感器的出货量约为8.79亿颗，同比下降18.8%左右。同时，在屏下指纹带动下，预计2019年全球指纹芯片的出货量将达到9.9亿颗，同比增长约12.5%。



## 产业合作

- 点评：
- ①罗德与施瓦茨基于华为巴龙5000成功调试5G NR手机信令测试方案。
  - ②UnitedSiC与ADI公司战略合作，开发基于SiC的产品和设备。
  - ③加速科技成果应用转化，胜利精密与成都光电所签署战略合作框架协议。



领域	合作公司/单位	目的
5G	罗德与施瓦茨、华为	双方在华为北京通信实验室打通了5G NR sub-6GHz信令电话。
功率半导体	UnitedSiC、ADI	双方围绕SiC器件领域达成战略投资和长期供应协议，具体条款尚未公布。
智能制造	胜利精密子、成都光电所	双方签署了《战略合作框架协议书》，进行全方位多层次的战略合作关系。此次合作的主要内容包括：互相参与产业机构、科技研发与产业项目合作、产业人才交流与合作培养等。



## 设计制造

- 点评：
- ①中芯长电在CSTIC上发布其最新集成封装技术SmartAiP。
  - ②三星电子第三代10纳米级DRAM开发成功。
  - ③谷歌号召成立CHIP联盟，推动开源芯片发展。
  - ④新傲科技SOI 30K生产线项目首台工艺设备搬。



## 【中芯长电在CSTIC上发布其最新集成封装技术SmartAiP】

SIIP CHINA  
SEMI产业创新投资平台

3月19日，中芯长电在中国国际半导体技术大会（CSTIC 2019）上发布世界首个超宽频双极化的5G毫米波天线芯片晶圆级集成封装SmartAiPTM（Smart Antenna in Package）工艺技术。SmartAiPTM具有集成度高、散热性好、工艺简练的特点，能够帮助客户实现24GHz到43GHz超宽频信号收发、达到12.5分贝的超高天线增益、以及适合智能手机终端对超薄厚度要求等的优势，并且有进一步实现射频前端模组集成封装的能力。

## 【华力微明年量产14nm FinFET】

3月21日，在SEMICON China 2019的先进制造论坛上，上海微电子华力微电子研发副总裁邵华发表演讲时表示，华力微电子今年年底将量产28nm HKC+工艺，明年年底则将量产14nm FinFET工艺。

## 【三星电子第三代10纳米级DRAM开发成功】

三星电子近日宣布第三代10纳米级（1z-nm）8GB超高性能和高功效的DRAM（Dynamic Random Access Memory，动态随机存取存储器）开发成功，将于下半年量产。新的DDR4 DRAM与之前的1Y纳米级版本相比，制造生产率提高了20%以上。



## 【谷歌号召成立CHIP联盟，推动开源芯片发展】

- ① Google等四家厂商和Linux基金会宣布，Linux基金会将为CHIP联盟专案（CHIP Alliance project）代管开源芯片装置设计相关的开源程式码，协助扩大开源芯片生态圈。
- ② CHIP全名为Common Hardware for Interface, Processor and Systems，首批联盟成员包括Google、Esperanto、SiFive及Western Digital等。该联盟旨在推动开源硬体，以及开放RISC-V架构的建立，进一步加速手机 / 平板等行动装置、电脑、网路设备及物联网装置芯片更弹性而有效率的设计。

## 【华为已开发一套操作系统】

根据《The Verge》报导，在接受德国媒体《世界报》访问时，华为消费者业务执行长余承东表示，他们已准备好自己的一套操作系统，如果不能再用Android系统或Windows系统，他们也有应对方式。

余承东表示，华为仍倾向于使用谷歌及微软的生态系统，但如果诉讼案情况变得更糟，他们已经准备好要使用自己的系统。



## 【新傲科技SOI 30K生产线项目首台工艺设备搬】

- ① 3月12日，新傲科技举办了“SOI 30K生产线项目首台工艺设备搬入仪式”，标志着新傲SOI 30K建设进入了冲刺阶段。
- ② 据新傲科技总经理王庆宇博士表示，“新傲科技8英寸SOI项目在各方的支持和努力下，经历了厂房改建、技术合作、产品论证、规模上量等多方面的挑战，一步一个脚印走到今天，非常不容易。目前，由于5G和电动汽车市场的快速发展，全球SOI材料需求旺盛，随着新傲科技SOI 30K项目建成，必将为国内和国际客户提供更多高品质的SOI材料。”

## 【赛普拉斯和SK海力士新设合资企业】

- ① 赛普拉斯 (Cypress) 和 SK 海力士新成立了一家名为SkyHigh Memory Limited的合资公司，目前已获得反垄断监管部门的批准。新公司预计将于2019年4月1日开始启动全面运营。
- ② 该合资企业将设立在香港，公司将负责其SLC NAND产品的生产、分销和技术支持，同时负责下一代NAND产品研发的相关投资。

## 【达摩院去年卖出芯片2亿片】

3月21日，在阿里云峰会上，阿里巴巴CTO、阿里云总裁张剑锋表示，达摩院在IoT端嵌入式芯片发展非常快，去年大概销售出去两亿片以上的芯片。



## 产品应用

点评：①雷达、传感器、AI、IMU等领域火热，各厂商纷纷推出新产品。



领域	公司/单位	产品及特性
光子芯片	Vishay	推出两款全新系列采用紧凑型DIP-6和SMD-6封装的光可控硅输出光耦——VOT8026A和VOT8123A，进一步扩展其光电产品组合。
UWB定位芯片	成都精位	推出了国产首颗UWB定位芯片JR3401、UWB定位发射模组JTM001和UWB接收模组JRW001。据成都日报报道，精位科技首颗UWB芯片的精确度、实时性等指标领先进口UWB定位芯片，主要运用于工业智能制造、自动驾驶等领域。
雷达芯片	加特兰	加特兰微电子在上海浦东嘉里大酒店正式发布了其革命性的Alps系列毫米波雷达系统单芯片。
传感器	Oxford Nanopore	推出Flongle，用于快速DNA和RNA测序。
传感器	Micro-Inertial	推出高性能IMU和运动传感系统。
传感器	ST	推出了一款具有化学兼容性、稳定性的高精度防水型MEMS压力传感器LPS33W，适用于可穿戴健身追踪器、真空吸尘器和通用工业传感器。
AR	韩国科学技术研究院	研制出一种高分辨率增强现实(AR)头挂式显示器(HMD)，该显示器具有全息光学元件。
AI	云米	发布了两款分别针对智能语音和视觉的AI芯片“悟空”。
路由器	华为	发布了一款名CPE Pro的路由器，号称是5G时代全球最快的5G路由器，3秒钟就能缓存一部1G的超清电影，与当前4G网络相比，提速高达21倍。
IMU	SBG Systems	惯性运动传感解决方案供应商SBG Systems近日发布了新款Horizon IMU，这是一款基于光纤陀螺（FOG）的高性能惯性测量单元（IMU），专为测量恶劣环境的大型水文测量船而设计。

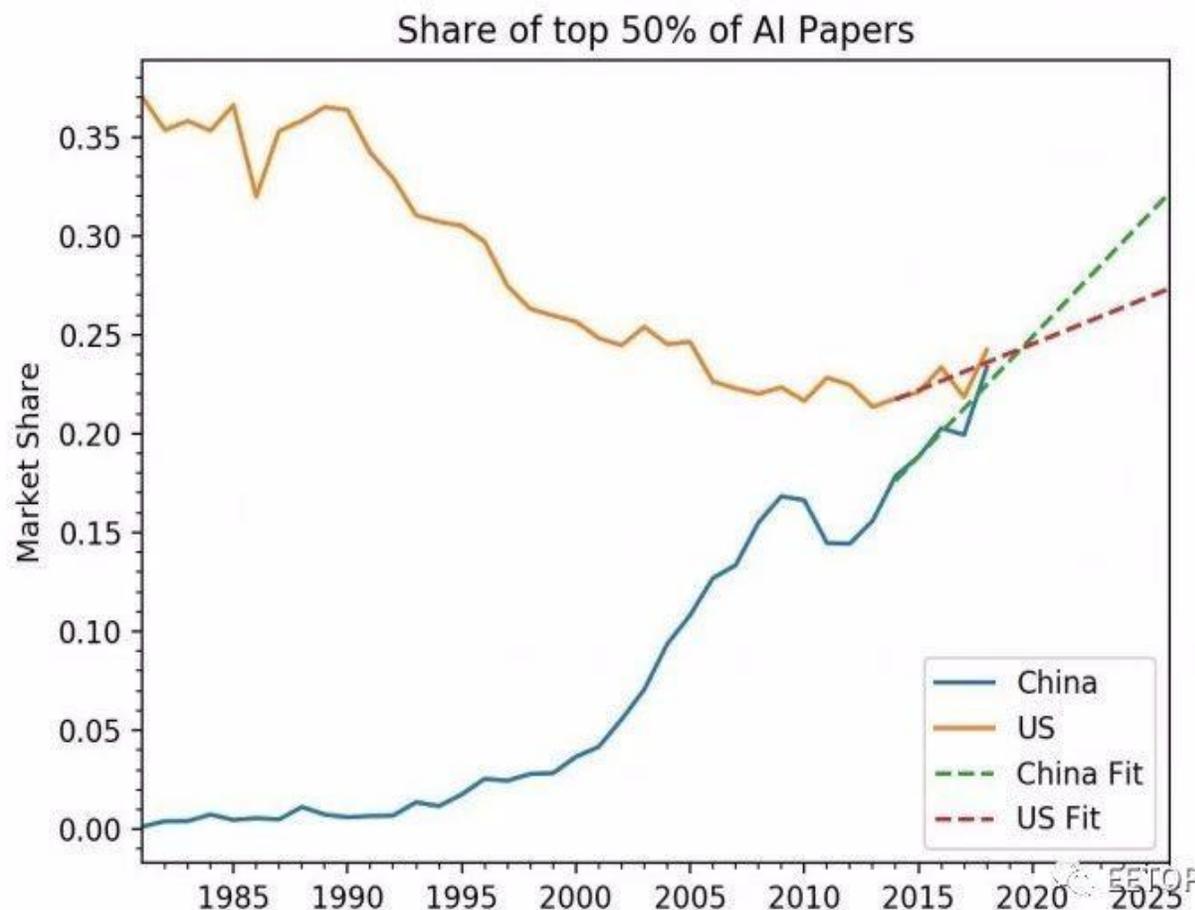


# 大国重器

点评：①艾伦人工智能研究所：中国2030年前有望成为全球AI研究领跑者。  
②国家发改委：2019重点支持国家科学中心建设，北京怀柔、上海张江、安徽合肥被点名。



## 【2030年中国AI研究有望领跑全球】



据美国科技媒体GeekWire报道，美国西雅图艾伦人工智能研究所（AI2）的一项最新分析表明，到2030年，中国有望成为人工智能领域的全球领跑者。



## 【科技部：2019年启动实施科技创新2030重大项目】

3月11日，科技部表示，2019年将做好科技重大专项2020年后接续实施的准备，启动实施科技创新2030重大项目。

## 【2019将重点支持国家科学中心建设，北京怀柔、上海张江、安徽合肥被点名】

- ① 3月17日，国家发改委发布了《关于2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告》。
- ② 报告指出，2019年将继续要加快建立京津冀协同创新共同体，支持北京、上海科技创新中心建设，支持北京怀柔、上海张江、安徽合肥3个综合性国家科学中心建设，以科技创新支撑长江经济带发展、长江三角洲区域一体化发展战略，研究和大力支持建设粤港澳大湾区国际科技创新中心并布局建设综合性国家科学中心。

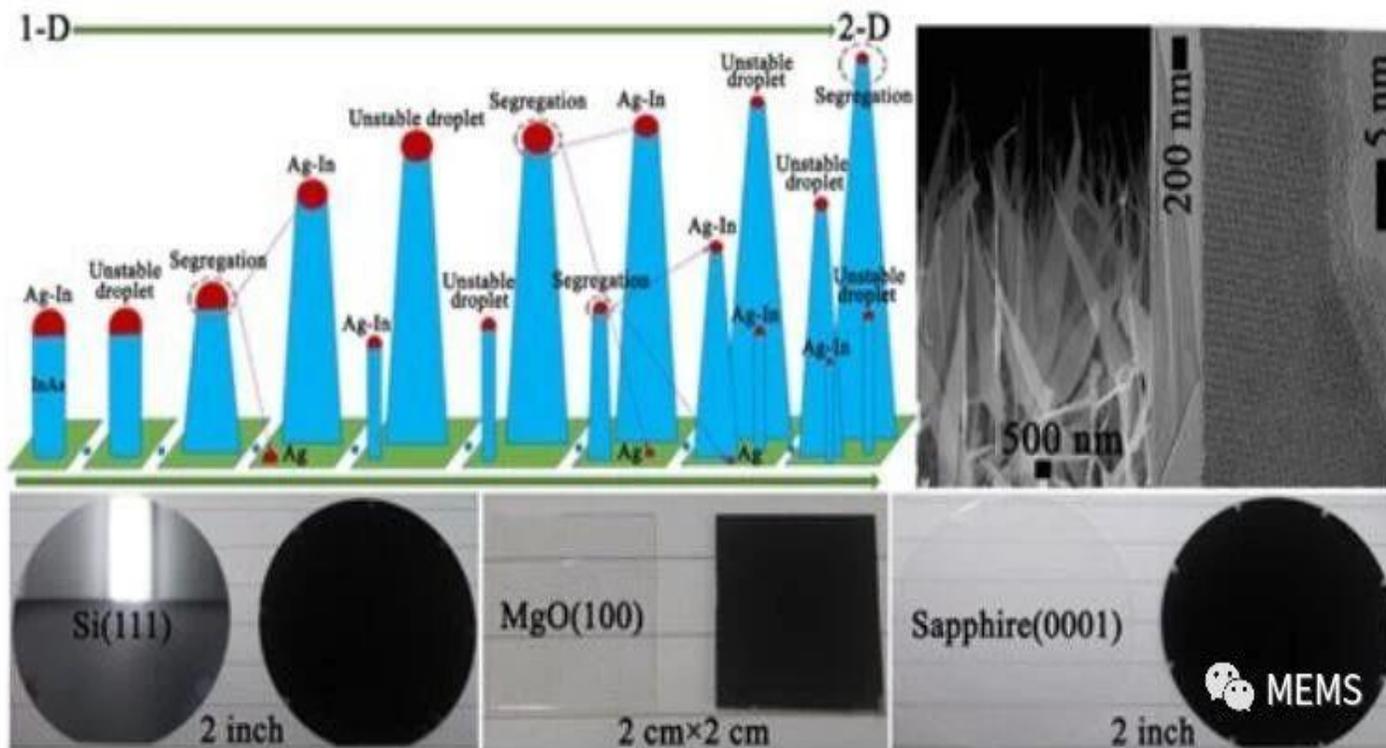


## 科技前沿

- 点评：
- ① 半导体所等实现晶圆级高质量InAs纳米结构的维度调控。
  - ② 复旦研制出二维体系中最高导电率新材料。
  - ③ 电子科大研制出单片集成全硅发光器件。



## 【半导体所等实现晶圆级高质量InAs纳米结构的维度调控】



- ① 最近，国际期刊《纳米快报》报道了中国科学院半导体研究所半导体超晶格国家重点实验室研究员赵建华团队与合作者在晶圆级高质量InAs纳米结构维度调控方面的最新研究成果。
- ② 赵建华团队副研究员潘东等发明了一种通过控制合金催化剂偏析实现晶圆级高质量InAs纳米结构的维度调控技术。



## 【复旦研制出二维体系中最高导电率新材料】

- ① 3月19日，材料领域国际顶级期刊《自然·材料》，发表复旦大学修发贤团队最新研究论文——《外尔半金属砷化铌纳米带中的超高电导率》。
- ② 修发贤团队新研制的砷化铌纳米带材料，电导率是铜薄膜的一百倍，石墨烯的一千倍，制备出了二维体系中具有目前已知最高导电率的外尔半金属材料——砷化铌纳米带。

## 【电子科大研制出单片集成全硅发光器件】

据科技日报报道，电子科技大学徐开凯课题组借助标准硅IC工艺研制出单片集成的全硅发光器件，实现基于PN结级联的高效多晶硅光源。这项技术的意义在于，取得了全硅半导体光电器件与集成技术领域的新突破。



# 人事变迁

点评：①华映宣布大裁员，将解雇约2500名员工。  
②台积电晶圆瑕疵门风波，牵动14B厂和品管部门高层换将。



## 【华映将解雇约2500名员工】

近日，面板厂华映公告人力调整计划，将依据劳动相关法令规定及程序办理，预估影响生产线员工及幕僚员工人数约2500人，等于解雇逾半数在台员工。

## 【安森美公司在其最大芯片厂开始裁员】

据外媒报道，随着整个半导体行业的销售下滑，安森美半导体正准备在其位于格雷舍姆的大型芯片工厂解雇数量不详的工人。

## 【台积电多名高管被换人】

- ① 前不久台积电由于光刻胶污染，导致大量晶圆报废，损失了上万片12寸晶圆，影响的且是主力营收的Fab 14B工厂的16/12nm工艺。
- ② 据报道，这次事件爆发地的台积电Fab14厂长日前已经调离，转调到品质部门任职。Fab14厂品质部门副总将会被提前安排退休。



## 焦点关注

点评：①科创板第一批受理公司出炉，晶晨、睿创微纳、和舰拔得头筹。  
②美国启动337调查，台积电、TCL等被告。



## 【科创板第一批受理公司出炉，晶晨、睿创微纳、和舰拔得头筹】

序号	发行人全称	审核状态	注册地	证监会行业	保荐机构	律师事务所	会计师事务所	更新日期	受理日期
1	武汉科前生物股份有限公司	已受理	湖北	医药制造业	招商证券股份有限公司	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市嘉源律师事务所	2019-03-22	2019-03-22
2	安翰科技(武汉)股份有限公司	已受理	湖北	专用设备制造业	招商证券股份有限公司	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市中伦律师事务所	2019-03-22	2019-03-22
3	和舰芯片制造(苏州)股份有限公司	已受理	江苏	计算机、通信和其他电子设备制造业	长江证券承销保荐有限公司	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京海润天睿律师事务所	2019-03-22	2019-03-22
4	宁波容百新能源科技股份有限公司	已受理	浙江	计算机、通信和其他电子设备制造业	中信证券股份有限公司	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	国浩律师(上海)事务所	2019-03-22	2019-03-22
5	广东利元亨智能装备股份有限公司	已受理	广东	专用设备制造业	民生证券股份有限公司	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	北京国枫律师事务所	2019-03-22	2019-03-22
6	江苏北人机器人系统股份有限公司	已受理	江苏	专用设备制造业	东吴证券股份有限公司	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	国浩律师(上海)事务所	2019-03-22	2019-03-22
7	江苏天奈科技股份有限公司	已受理	江苏	化学原料和化学制品制造业	民生证券股份有限公司	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市中伦律师事务所	2019-03-22	2019-03-22
8	烟台睿创微纳技术股份有限公司	已受理	山东	计算机、通信和其他电子设备制造业	中信证券股份有限公司	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市中银律师事务所	2019-03-22	2019-03-22
9	晶晨半导体(上海)股份有限公司	已受理	上海	计算机、通信和其他电子设备制造业	国泰君安证券股份有限公司	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市君合律师事务所	2019-03-22	2019-03-22

3月22日，上交所官网公布了首批受理科创板的IPO企业名单，包括广东利元亨智能装备股份有限公司、江苏北人机器人系统股份有限公司、江苏天奈科技股份有限公司、烟台睿创微纳技术股份有限公司、晶晨半导体（上海）股份有限公司、武汉科前生物股份有限公司、安翰科技（武汉）股份有限公司、和舰芯片制造（苏州）股份有限公司、宁波容百新能源科技股份有限公司。



## 【美国启动337调查，台积电、TCL等被告】

- ① 近日，美国国际贸易委员会决定对特定半导体器件、集成电路产品启动337调查。
- ② 涉案的中国企业包括OPPO、vivo、步步高、TCL、海信、联发科和晨星半导体等，同时美国高通和台积电在美分公司也被列为被告之一。



# 专利要闻

点评：①智能手机应用领域竞争激烈，龙头企业竞相申请新专利。



类别	公司/单位	事件内容
新专利	苹果	新专利：要用静脉匹配技术 Face ID独一无二。
新专利	华为	正反双屏手机曝光：前置3D ToF摄像头。
新专利	微软	新专利曝光：改善VoIP通话质量低干扰等问题。
新专利	福特	新专利：将卡车车厢变成电影院。
新专利	努比亚	新专利曝光：红魔游戏手机将配备散热风扇。
新专利	蔚来	多项新专利：致力于解决电池过热问题。
新专利	索尼	新专利：PlayStation VR 2可能拥有无线功能，可自动切换信号频段。
新专利	谷歌	可折叠手机专利曝光：采用向外折叠设计。



# SIIP CHINA

【SEMI产业创新投资平台-SIIP CHINA】是依托SEMI全球产业资源，汇聚全球产业资本、产业智慧搭建的专业而权威的产业投融资交流平台。SIIP CHINA产业创新投资平台，旨在推进中国半导体产业可持续发展，提供全球技术与投资对接机遇，促进中国与全球合作伙伴的协作，寄期望平台成为大半导体业界最具影响力的产业投资平台。



## 联系我们

SEMI中国 Lily Feng  
Tel: +86-21-60278500  
E-MAIL: lifeng@semi.org  
<http://www.semi.org.cn/siip>

**订阅半导体产业新闻半月刊（精华版）欢迎来信索取**  
(来信请附名片并注明公司名称、职务、联系电话)  
SEMI中国 Lily Feng  
E-MAIL: lifeng@semi.org

